

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-260571

(43)公開日 平成6年(1994)9月16日

(51)Int.Cl.  
H 01 L 23/36  
H 05 K 7/20

識別記号 庁内整理番号  
D 8727-4E

F I  
H 01 L 23/36

技術表示箇所  
Z

審査請求 未請求 請求項の数3 O.L (全3頁)

(21)出願番号

特願平5-47039

(22)出願日

平成5年(1993)3月9日

(71)出願人 000005234

富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

(72)発明者 今村一彦

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内

(74)代理人 弁理士 山口巖

(54)【発明の名称】 冷却フィン

(57)【要約】

【目的】半導体素子等の発熱部品を搭載しその放熱冷却を行う冷却フィンの軽量化と低廉化とを図る。

【構成】冷却フィンの発熱部品取付部と冷却リブとを一枚板の薄物金属板1のプレス加工によりくし歯状に形成し、部品取付面の厚さ( $t_1$ )、冷却リブの厚さ( $t_2$ )、冷却リブの高さ(H)及びピッチ(p)等に関する寸法上の制約を除き、前記冷却フィンの寸法設計上の自由度の増大と製造上の簡易化とを行いその軽量化と低廉化とを図る。

